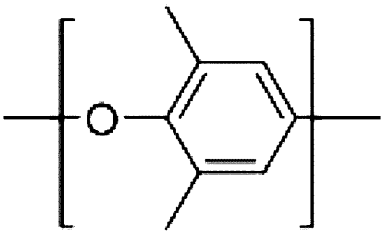
【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第３区分
【発行日】令和4年11月29日(2022.11.29)

【国際公開番号】WO2022/131127
【出願番号】特願2022-532085(P2022-532085)
【国際特許分類】
C08F 2/44(2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０８Ｆ 2/44 B

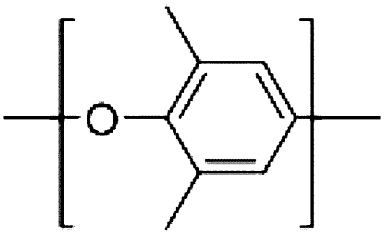
【手続補正書】
【提出日】令和4年5月30日(2022.5.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
シェル部と該シェル部により囲われた中空部分を有する中空樹脂粒子であって、
該中空部分が１つの中空領域からなり、
該シェル部が、式（１）により表されるエーテル構造を有する、
中空樹脂粒子。
【化１】



(1)

【請求項２】
平均粒子径が０．１μｍ～５０．０μｍである、請求項１に記載の中空樹脂粒子。
【請求項３】
前記中空樹脂粒子を窒素雰囲気下において１０℃／分で昇温した際の５％熱重量減少温度が３００℃以上である、請求項１または２に記載の中空樹脂粒子。
【請求項４】
半導体部材用樹脂組成物に用いる、請求項１から３までのいずれかに記載の中空樹脂粒子。
【請求項５】
塗料組成物に用いる、請求項１から３までのいずれかに記載の中空樹脂粒子。
【請求項６】
断熱性樹脂組成物に用いる、請求項１から３までのいずれかに記載の中空樹脂粒子。
【請求項７】
光拡散性樹脂組成物に用いる、請求項１から３までのいずれかに記載の中空樹脂粒子。
【請求項８】
光拡散フィルムに用いる、請求項１から３までのいずれかに記載の中空樹脂粒子。
【請求項９】

請求項１から３までのいずれかに記載の中空樹脂粒子を含む、半導体部材用樹脂組成物。
【請求項１０】
請求項１から３までのいずれかに記載の中空樹脂粒子を含む、塗料組成物。
【請求項１１】
請求項１から３までのいずれかに記載の中空樹脂粒子を含む、断熱性樹脂組成物。
【請求項１２】
請求項１から３までのいずれかに記載の中空樹脂粒子を含む、光拡散性樹脂組成物。
【請求項１３】
請求項１から３までのいずれかに記載の中空樹脂粒子を含む、光拡散フィルム。
【請求項１４】
請求項１から８までのいずれかに記載の中空樹脂粒子の製造方法であって、
式（１）により表されるエーテル構造を有する化合物（Ａ）２０重量部～８０重量部と該化合物（Ａ）と反応するモノマー（Ｂ）８０重量部～２０重量部（化合物（Ａ）とモノマー（Ｂ）の合計量を１００重量部とする）を、非反応性溶剤の存在下、水系媒体中で反応させる、
中空樹脂粒子の製造方法。
【化２】



(1)